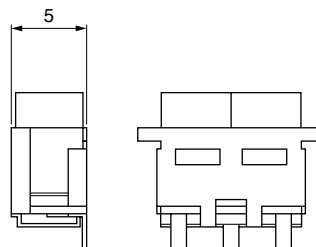
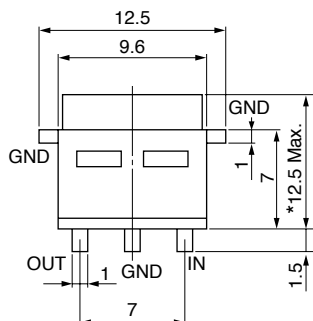


TYPE 4DFA (2 Pole SMD Type)

Frequency Range: 800~2500MHz

Temperature Range: -40°C~+85°C



Tolerance: ± 0.5

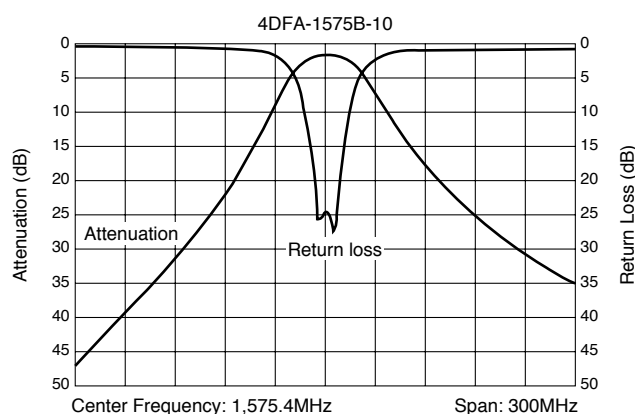
*: Depends on Center Frequency.
*: 長さは周波数に依存します。

(Unit: mm)

Measurement values: 4DFA-1575B-10

Passband Insertion Loss	1.42dB
Passband Ripple	0.12dB
Passband V.S.W.R.	1.13
Attenuation	
at 1540.4MHz	11.3dB
at 1610.4MHz	8.9dB
at 1435.4MHz	44.2dB
at 1715.4MHz	33.9dB

Characteristics 特性曲線



SELECTION GUIDE FOR STANDARD DEVICES

The Part Numbers shown in the table below are standard devices, which are readily available. TOKO will design and manufacture modified and custom devices with specific characteristics to meet your requirements. If you do not find the device for your application in this catalog, please contact our sales or representative office.

下記の表に示す製品番号は、標準品です。TOKOは、お客様のご要望に合わせて設計、製作いたしますので、お客様の用途に適合する仕様が見当たらない場合は、当社営業所または代理店にご連絡ください。

TYPE 4DFA: SMD 2 Pole Designs

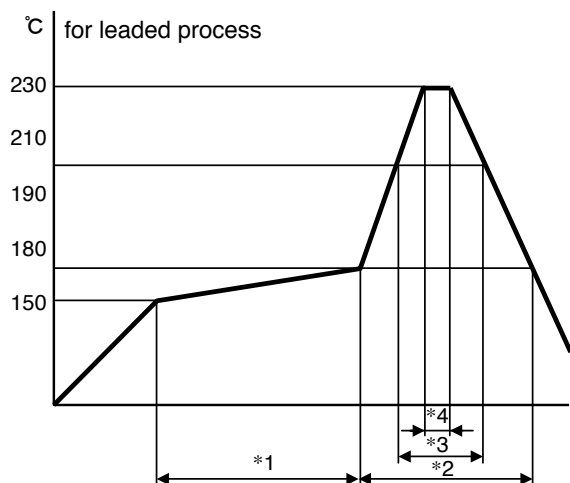
東光品番	中心周波数	帯域幅	挿入損失	帯域内リップル	V.S.W.R.	選択度	応用例
TOKO Part Number	Center Frequency (MHz)	Bandwidth (fo ± MHz)	Insertion Loss (dB) Max.	Ripple in BW (dB) Max.	V.S.W.R. in BW Max.	Selectivity (dB) Min. (MHz)	Application
4DFA-836E-10	836.5	± 12.5	2.0	1.0	2.0	18 (fo ± 77.5)	AMPS
4DFA-881E-10	881.5	± 12.5	2.0	1.0	2.0	18 (fo ± 77.5)	AMPS
4DFA-964E-10	964.0	± 12.5	2.0	1.0	2.0	18 (fo ± 77.5)	AMPS
4DFA-902E-10	902.5	± 12.5	2.0	1.0	2.0	18 (fo ± 77.5)	NMT/GSM
4DFA-947E-10	947.5	± 12.5	2.0	1.0	2.0	18 (fo ± 77.5)	NMT/GSM
4DFA-866A-10	866.0	± 2.0	3.0	1.0	1.43	30 (fo - 105)	CT2
4DFA-886A-10	886.0	± 1.0	3.0	1.0	2.0	22 (fo ± 45)	Cordless Phone
4DFA-931A-10	931.0	± 1.0	3.0	1.0	2.0	22 (fo ± 45)	Cordless Phone
4DFA-915E-10	915.0	± 13.0	2.2	1.0	2.0	18 (fo ± 77.5)	Spread Spectrum
4DFA-1227B-10	1227.0	± 5.0	2.0	0.8	2.0	7, 30 (fo ± 35, ± 140)	GPS
4DFA-1227B-11	1227.0	± 5.0	1.2: 0.7 Typ.	0.5	2.0	15, 20 (fo + 140, - 140)	GPS
4DFA-1575B-10	1575.4	± 5.0	2.0: 1.4 Typ.	0.8	2.0	7, 30 (fo ± 35, ± 140)	GPS
4DFA-1575B-12	1575.4	± 5.0	1.2: 0.7 Typ.	0.5	2.0	17, 20 (fo + 140, - 140)	GPS
4DFA-1575B-14	1575.4	± 5.0	2.5: 1.8 Typ.	0.8	2.0	17 (fo ± 50)	GPS
4DFA-1550L-10	1550.0	± 30.0	1.2: 0.7 Typ.	0.7	2.0	12, 16 (fo + 150, - 150)	MCSS
4DFA-1890D-10	1890.0	± 10.0	2.0	1.0	2.0	20 (fo ± 89)	DECT
4DFA-1903C-10	1903.0	± 8.0	2.7	1.0	2.0	15, 27 (fo ± 50, ± 100)	JDCT
4DFA-2442P-10	2442.0	± 40.0	2.5	1.0	2.0	15 (fo ± 250)	Spread Spectrum
4DFA-2500A-10	2500.0	± 2.0	3.0	1.0	2.0	18, 25 (fo ± 60, ± 90)	VICS

入出力インピーダンス / Input Output impedance : 50Ω

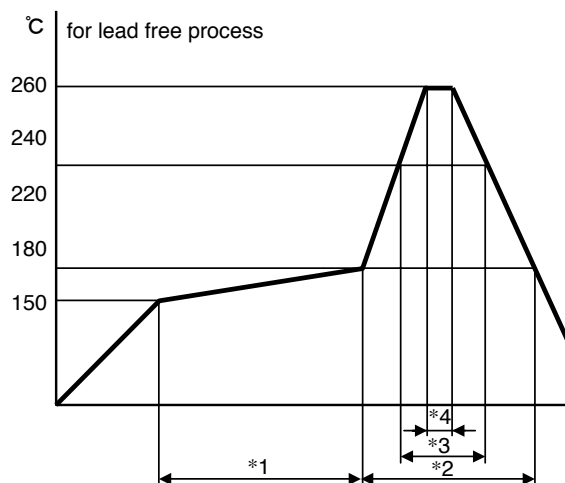
■ PRECAUTIONS AND RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS FOR USING DIELECTRIC FILTERS SURFACE MOUNT TYPE

面実装誘電体フィルタご使用上の注意・推奨はんだ付け条件

Temperature profile (land surface temperature)
温度プロファイル (ランド部表面温度)



Pre-heat conditions	予熱部
*1 : 150~160°C 60s. Max.	*1 : 150~160°C 60秒以内
Reflow conditions	リフロ部
*2 : 160°C Min. 45s. Max.	*2 : 160°C以上 45秒以内
*3 : 200°C Min. 30s. Max.	*3 : 200°C以上 30秒以内
*4 : 230±5°C 5s. Max.	*4 : 230±5°C 5秒以内



Pre-heat conditions	予熱部
*1 : 150~180°C 120s. Max.	*1 : 150~180°C 120秒以内
Reflow conditions	リフロ部
*2 : 180°C Min. 150s. Max.	*2 : 180°C以上 150秒以内
*3 : 230°C Min. 40s. Max.	*3 : 230°C以上 40秒以内
*4 : 260±5°C 5s. Max.	*4 : 260±5°C 5秒以内

1. Reflow solder conditions

• Solderability

When flux-mounted terminals are immersed in solder at following conditions, at least 95% of the surface should be covered by solder.

Conditions

leaded process : 230±5°C for 3±0.5 seconds
lead free process : 260±5°C for 3±0.5 seconds

• Solder heat resistance

No abnormalities under solder conditions of
leaded process : 230±5°C for 5 seconds
lead free process : 260±5°C for 5 seconds

2. Rinsing

After Soldering, you should rinsing away the excess flux. Any commercially available rinsing agent may be used.

3. Other Precautions

Perform soldering at as low a temperature as possible and for as short a time as possible. Make sure that the silver electrode of resonators is not covered by solder. Avoid applying external forces to terminals such as by bending or cutting them.

4. Iron Soldering

Perform iron soldering with iron at following conditions.
Conditions
leaded process : 350±5°C for 5s. Max.
lead free process : 390±5°C for 5s. Max.

1. リフロはんだ条件

• はんだ付け性

フラックス付けた端子部を以下の条件ではんだ中に浸漬し95%以上の面積がはんだで覆われること。

条件

有鉛品 : 230±5°Cのはんだ中に3±0.5秒浸漬
鉛フリー品 : 245±5°Cのはんだ中に3±0.5秒浸漬

• はんだ耐熱性

以下のはんだ付け条件で異常のないこと。

有鉛品 : 230±5°C、5秒間
鉛フリー品 : 260°C、5秒間

2. 洗浄

はんだ付け後のフラックスの洗浄をして下さい。洗浄液として一般的に使用されている全ての洗浄液が使用できます。

3. その他留意事項

はんだ付けは極力低い温度で短時間で行って下さい。共振器の銀電極にはんだが付着しないようにして下さい。端子を曲げたり、切断するなど、端子部分に外力を加えることは避けて下さい。

4. こてはんだ

有鉛品 : こて先温度350°C以下、加熱時間5秒以内、1回
鉛フリー品 : こて先温度390±10°C、加熱時間5秒以内、1回